



EV GROUP BRINGT AUTOMATISCHES METROLOGIE-SYSTEM FÜR FERTIGUNGSANWENDUNGEN IN DEN BEREICHEN ADVANCED PACKAGING, MEMS UND PHOTONIK AUF DEN MARKT

Der EVG[®]50 erlaubt als flexible, auf Kundenbedürfnisse anpassbare Standalone-Lösung hochauflösende Messungen entscheidender Parameter für Waferbond- und Lithographieprozesse bei hohem Durchsatz

ST. FLORIAN, Austria, 11. Juli 2016 - EV Group (EVG), ein führender Entwickler und Hersteller von Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie, stellte heute das automatische Metrologiesystem EVG[®]50 vor. Das System führt zerstörungsfreie, hochauflösende Schichtdicken- und Topographiemessungen in mehreren Ebenen sowie Fehleranalysen von gebondeten Waferstapeln und Fotolacken in der optischen Lithographie durch und unterstützt damit die kontinuierlich steigenden Anforderungen bei Fertigungsanwendungen in den Bereichen Advanced Packaging, MEMS und Photonik. Das System kann Schichten mit Dicken von nur zwei Mikrometern messen, erfasst bis zu einer Million Messpunkte und erreicht dabei einen Durchsatz von bis zu 55 Wafern mit 300 mm Durchmesser pro Stunde. Diese Kombination aus extrem hoher Auflösung und hohem Durchsatz erlaubt die vollständige Wafer-Inspektion und ermöglicht Device-Herstellern die Optimierung ihrer Waferbond- und Lithographieprozesse und die Erhöhung ihrer Produktionsausbeute.

Dr. Thomas Glinsner, Corporate Technology Director bei EV Group merkte an: "In der Halbleiterindustrie ist ein Trend zur vollständigen Überwachung und Kontrolle aller Produktionsprozesse zu beobachten. Mid-End-Of-Line und Back-End Packaging Prozesse unterliegen inzwischen ebenfalls strengeren Randbedingungen, die so bisher nur bei der Waferbearbeitung im Front-End-Of-Line Bereich üblich waren. Das führt zur Nachfrage nach hochpräzisen In-Line-Metrologielösungen, die kritische Prozessdaten schnell und kosteneffizient liefern können. Der EVG50 erreicht die gestellten Anforderungen mit konkurrenzloser Geschwindigkeit und Auflösung und stellt somit eine wichtige Ergänzung unserer Lösungen im Bereich Metrologie dar."

Konsequente Weiterentwicklung der in der Industrie erfolgreich eingesetzten Metrologielösungen

Der EVG50 als Standalone-System wurde auf der Basis des bestehenden In-Line Metrologie Modules (IMM) entwickelt, das als Option für EVGs 300 mm Prozessanlagen angeboten wird und bereits in zahlreichen Anwendungen in der Großserienproduktion implementiert wurde. Der EVG50 zielt auf die Anforderungen der Kunden für die ganzflächige Schichtdicken- und Topographiemessung in kritischen Anwendungen. Das System wurde als Ergänzung zu EVGs vielseitigem EVG[®]40NT Measurement System entwickelt, das den Industriestandard für die Bond Overlay Inspektion darstellt. Der hohe Durchsatz und die beispiellose Genauigkeit des EVG50 selbst bei extrem hohen Auflösungen ermöglicht die kosteneffiziente, 100-prozentige Überprüfung von Wafern in der laufenden Produktion und führt dadurch zu einer verbesserten Prozessüberwachung.

Die Vielseitigkeit des EVG50 erlaubt die Messung der Schichtdicken in Lithographie-Prozessen, der Wölbung von Wafern sowie Fehleranalysen von gebondeten Waferstapeln auf dem gleichen System. Das Handling mit geringstem Kontakt am Wafertrand ermöglicht eine partikelfreie Inspektion über die gesamte Waferfläche. Ein weiterer, wichtiger Vorteil des EVG50 ist seine Flexibilität. Dank einer Mehrfach-Sensoraufnahme kann das System kundenspezifisch für unterschiedlichste Substrat-Arten und -Dicken ausgelegt werden, zudem sorgt seine Fähigkeit zur Selbstkalibrierung für eine bessere Reproduzierbarkeit und Verfügbarkeit in der laufenden Produktion.

Journalisten, Analysten und potenzielle Kunden, die mehr über EVGs Portfolio von Metrologielösungen und speziell zum EVG50 erfahren möchten, sind eingeladen, während der SEMICON West vom 12.-14. Juli 2016 den EV Group Messestand #1017 in der South Hall des Moscone Convention Centers in San Francisco zu besuchen.

Mehr Informationen und Fotos zu EVGs Metrologie-Lösungen und zum EVG50 sind auf der Webseite des Unternehmens unter <http://www.evgroup.com/en/products/bonding/inspectionssystem/evg50/> verfügbar.

Über EV Group (EVG)

Die EV Group (EVG) ist anerkannter Technologie- und Marktführer für Präzisionsanlagen und Prozesslösungen zur Waferbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie. Zu den Kernprodukten gehören Waferbonder, Systeme zur Dünnwafer-Bearbeitung, Lithographie- und Nanoprägelithographie-Systeme sowie Fotoresist-Belacker, Reinigungs- und Metrologiesysteme. Das 1980 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Florian am Inn (Austria) beschäftigt mehr als 750 Mitarbeiter und betreut mit eigenen Niederlassungen in USA, Japan, Korea, Taiwan und China sowie Repräsentanzen namhafte Produktionskunden und R&D-Partner in aller Welt. Für mehr Informationen siehe www.EVGroup.com.

Kontakt:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Vice President
MCA, Inc.
Tel: +1.650.968.8900, ext. 125
E-mail: dmoreno@mcapr.com

###